

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-06

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
活动参与人员（排名不分先后）	建银国际、CIC HK
上市公司接待人员	战略发展部总监、证券事务代表：谢丹
时间	2025年2月7日
地点	电话及网络会议
形式	电话及网络会议
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司主营业务基本情况。</p> <p>公司专注于电子互联领域，拥有印制电路板、电子装联、封装基板三项主营业务，形成了业界独特的“3-In-One”业务布局，印制电路板与封装基板业务“技术同根”，电子装联与印制电路板业务“客户同源”，三项业务在各自领域相继拓展的同时，高效协同共筑起公司电子电路互联技术能力平台。公司具备提供“样品→中小批量→大批量”的综合制造能力，通过开展方案设计、制造、电子装联、微组装和测试等全价值链服务，能够为客户提供专业高效的一站式综合解决方案。业务产品下游应用广泛，拥有较为深厚的行业积淀和扎实的客户基础。</p> <p>Q2、请介绍公司 PCB 业务主要产品下游应用分布情况。</p> <p>公司在 PCB 业务方面从事高中端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作，产品下游应用以通信设备为核心（覆盖无线侧及有线侧通信），重点布局数据中心（含服务器）、汽车</p>

	<p>电子（聚焦新能源和 ADAS 方向）等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。</p> <p>Q3、请介绍公司是否具备 HDI 工艺技术能力。</p> <p>HDI 作为一项平台型工艺技术，可实现 PCB 板件的高密度布线。公司 PCB 业务具备 HDI 工艺能力，主要应用于通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等下游领域的部分中高端产品。</p> <p>Q4、请介绍公司 PCB 业务近年来扩产规划。</p> <p>公司 PCB 业务在深圳、无锡、南通及泰国项目（在建）均设有工厂。一方面，公司可通过对现有成熟 PCB 工厂进行持续的技术改造和升级，增进生产效率，释放一定产能；另一方面，公司在南通基地尚有土地储备，具备新厂房建设条件，南通四期项目已有序推进建设工程，拟建设为具备覆盖 HDI 等能力的 PCB 工艺技术平台。公司将结合自身经营规划与市场需求情况，合理配置业务产能。</p> <p>Q5、请介绍公司在封装基板领域的产品布局情况。</p> <p>公司封装基板产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。公司目前已具备包括 WB、FC 封装形式全覆盖的 BT 类封装基板量产能力。ABF 类封装基板具备 FC-BGA 16 层及以下产品批量生产能力和 16 层以上样品制造能力，相关客户认证及产能爬坡工作有序推进。</p> <p>Q6、请介绍广州封装基板项目连线爬坡进展。</p> <p>公司广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线，产品线能力持续提升，已承接部分产品订单。目前其产能爬坡尚处于前期阶段，重点仍聚焦平台能力建设，推进客户各阶产品认证工作，其认证周期相较其他 PCB 及封装基板产品所需时间更长。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>

附件清单	无
------	---